

Rework

Das Feld an professionellen Rework-Möglichkeiten ist bei BMK nahezu grenzenlos

Der Tausch von Bauelementen beginnt bei 0402 Chips und geht über Fine Pitch Bauteile bis zu komplexen Prozessor- und Speicherbausteinen der Bauformen μ BGA, BGA und LGA Sockel. BGA Reballing ist eine von uns häufig angewandte Methode, um werthaltige Bauteile erneut einzusetzen. Das Thema Rework beschränkt sich nicht nur auf Hardwareänderungen, sondern deckt auch das Themengebiet der Softwareanpassungen mit ab. Das Aufspielen von aktuellen SW-Images und Änderungen im Rahmen der Firmware sind zwei Beispiele aus diesem Dienstleistungsspektrum. Gerätemontage bis hin zur kompletten Aufarbeitung (Refurbishment) inklusive Produkttest runden unser Angebot an Dienstleistungen ab.

Ihr Produkt ist bei uns in den allerbesten Händen. Wir arbeiten nach den **IPC Standards 7711 & 7721** - und das zu günstigsten Preisen.

Weitere Informationen:

- **Chip Level Reparatur**